

GP450H 导热垫片

产品介绍

GP450H 导热垫片导热系数高达 4.5 W/m-K，该产品具有优异的机械强度，同时还保持了柔软的特性。

GP450H 使用含硅的基础油，具有很高的导热系数和极宽的工作温度范围，它所具有的优异性能来自于成分中的各种金属氧化物，这些绝缘材料的应用也确保了导热垫片接触到系统中其它部分时不会造成漏电。

GP450H 适于那些需要迅速而有效地排出大量热的环境。热源（如半导体阻挡层）产生的热量在通过自由或强制对流排出前需要通过很多不同的材料层，需要注意的是如果将使用导热垫片的界面的导热系数在系统中最小，即是速率决定点，通常需要导热垫片帮助散热。

散热的速率取决于温差、层厚及材料的导热系数。

Electrolube 提供多种导热产品，包括导热硅脂(HTS, HTSP)和无硅导热脂(HTC, HTCP, HTCPX)，常温硫化硅橡胶（TCOR, TCER），导热粘接材料（TBS）及环氧灌封树脂（ER2074）。

特点

- * 导热系数高达 4.5 W/m-K
- * 即使在高温下仍具有极佳的导热系数
- * 优异的机械强度
- * 工作温度范围宽，低挥发重量损失。
- * 阻燃性能符合 UL94 V0

认证

RoHS

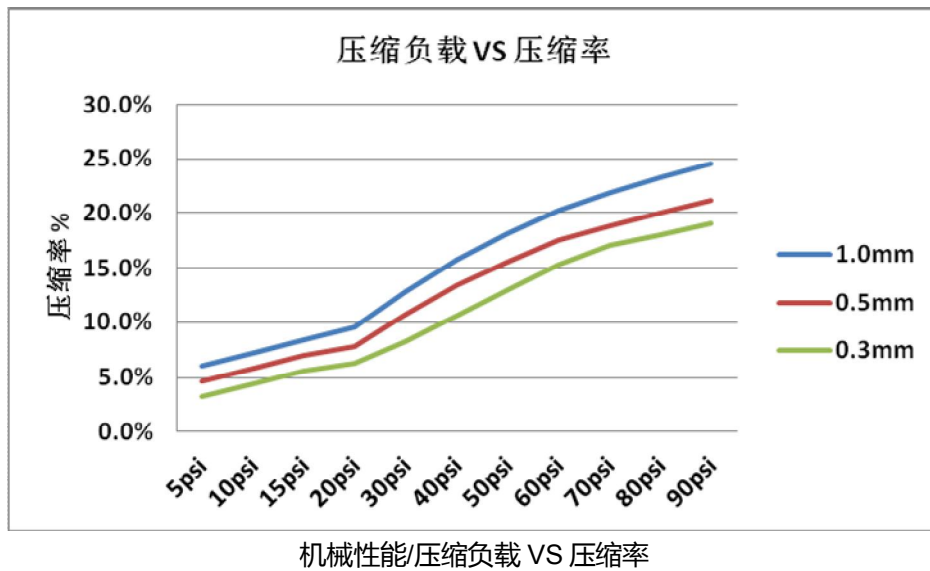
符合

应用

在二极管、晶体管、闸流晶体管、散热器、硅整流器、半导体、控温器、功率电阻器及冷却器的装配柱和基座等发热器件与散热器件间贴上垫片。

性能

颜色:	淡蓝色
导热组分:	金属氧化物
导热系数:	4.5 W/m-K
厚度:	0.5~5.0mm
硬度(Shore 00):	55
密度 @ 20°C:	3.2g/cm ³
拉伸强度:	0.2MPa
断裂伸长率	83%
热阻@ 1.0mm,20psi:	0.41°C-in ² / W
热阻@ 0.5mm,20psi:	0.32°C-in ² / W
热阻@ 0.3mm,20psi:	0.21°C-in ² / W
绝缘强度:	15 KV/mm
工作温度范围:	-50°C — +200°C
阻燃等级	UL94 V-0



包装

200*400mm (可根据客户要求生产、加工各种尺寸、厚度产品)